Simple is The Best!!

卓上型 基板最終外観検査装置

MO-EYE

TY-VISION Micro Optical - eye

■５分間検査データ作成
■虚報を抑えた高速検査
■驚きの低価格化を実現

JPCA Show 2012 東・5 B-20

太洋工業株式会社
www.taiyo-xelcom.co.jp
■ 本　社　：〒640-8390　和歌山市有本 661 番地　TEL⇒073-431-6311（代）　FAX⇒073-432-5469
■ 東京事業所：〒102-0073　東京都千代田区九段北 1-3-3 九段下東急真サクラビル 7F　TEL⇒03-3261-6301
海外拠点：上海・広州・タイ［バンコク：TAIYO TECHNOLEX(THAILAND)CO., LTD.］



JCU

Next Challenge

荏原ユージライトは、高密度実装、微細化、最新パッケージング、環境対応など、次世代エレクトロニクスの課題に迅速に応えるために、表面処理薬品、各種プロセスや装置の開発・提供を通じて、「先端のものづくり」に貢献してまいります。

■電子部品用めっきプロセス
■プリント配線板用めっきプロセス
■半導体ウエハ対応めっきプロセス
■ドライプロセス
■表面処理装置

JPCA Show 2012
ブースNo. 東2ホール 2R-04

荏原ユージライト株式会社　〒110-0015 東京都台東区東上野 4-8-1 TIXTOWER UENO　TEL.03-6895-7001　FAX.03-6895-7021
〈国内〉本社営業部、大阪支店、名古屋支店、九州営業所、国際営業部　〈海外〉中国、台湾、韓国、タイ、ベトナム、インドネシア、インド、メキシコ


# JPCA Show 2012

## きょう開幕

15日（金）まで東京ビッグサイト

## 最先端機器を支える技術が集結

最先端機器を支える電子回路・実装技術が集結する「JPCA Show2012 第42回国際電子回路産業展」「ラージエレクトロニクスショー2012」「2012マイクロエレクトロニクスショー 第26回最先端実装技術・パッケージング展」「JISSO PROTEC2012 第14回実装プロセステクノロジー展」の4展示会が、きょう13日（水）から15日（金）までの3日間、東京・有明の東京ビッグサイトで開催される。開場時間は10時から17時まで。

JPCA Showは「2012プリント配線板技術展」「2012半導体パッケージング・部品内蔵技術展」「2012機器・半導体受託生産システム展」で構成され、日本電子回路工業会（JPCA）の主催。ラージエレクトロニクスショーは「2012プリンテッドエレクトロニクス最適生産システム展」が新設されるほか、「2012LED／OLED応用技術展」「2012部品・MEMS／デバイス産業総合資機材展」で構成され、JPCAと半導体産業新聞の共催。

マイクロエレクトロニクスショーはエレクトロニクス実装学会（JIEP）、JISSO PROTECは日本ロボット工業会（JARA）の主催。このほか、「ものつくりフェスタ2012」が開かれ、展示会全体の運営をJPCAが行う。入場料は1000円。ただし、招待券持参者およびインターネットでの事前登録者は無料。

今年はJPCA創立50周年、JIEP合併発足14周年、JARA創立40周年の節目の年に当たる。これを記念して4展示会を包含する総称を公募し、共通名称を決定する。展示会は電子回路・実装技術や今後普及が見込まれるラージエレクトロニクスの製品・技術情報の提供を通じて、電子回路業界と関連業界全体の発展を図るのが狙い。

今、国内電子回路産業は大きな変革の波にさらされ、次世代に向けた新たな方向へかじを切ることが求められている。こうした状況を踏まえ、国内外に「日本のものつくり」を力強く発信していく。

## 3展構成で多彩な展示

JPCA Show 2012 第42回国際電子回路産業展

JPCA Showは電子回路・実装技術専門展示会として国際的に最も歴史があり、これまでも世界中に電子回路技術を発信する場として高く評価されている。

JPCAがまとめた2012年の電子回路産業の生産見通しによると、国内電子回路基板は前年比1・6％増の8210億円を見込む。品種別ではプリント配線板が同1・3％増、モジュール基板が同2・1％増、中でも10層以上の多層プリント配線板が同14・3％増と高い伸びを見込んでいる。ビルドアップ配線板が同4・2％増と本来の成長性を回復する伸びとなっている。将来予測では環境対応技術など潜在的な需要の拡大要因が大きいことから、16年までの5年間は年平均3・3％のプラス成長を見込む。

展示会構成と出展内容は次の通り。

①「プリント配線板技術展 PWB Tech」＝片面・両面・多層プリント配線板、フレキシブルプリント配線板（FPC）、ビルドアップ配線板、フレックスリジッド配線板などの製品と、製造装置など。

②「半導体パッケージング・部品内蔵技術展 Module Japan」＝リジッドサブストレート、ビルドアップサブストレート、COF／テープ自動ボンディング（TAB）、リジット系能動（受動）部品内蔵電子回路基板、フレキシブル系能動（受動）部品内蔵電子回路基板、微小電気機械システム（MEMS）埋め込み型部品内蔵電子回路基板などの製品と、各種合金（鉄―ニッケル系、銅系）などの材料および製造装置など。

③「機器・半導体受託生産システム展 EMS Japan」＝プリント配線実装基板、モジュール実装基板、挿入部品実装基板、チップ部品実装基板、ICパッケージ実装基板、ワイヤボンディング実装基板などの製品と、材料、製造装置、プロセス資機材など。

## 低コスト・大量生産に貢献

ラージエレクトロニクスは、各種の方法によってパターンおよび素子を大面積に再現する技法。その応用製品として太陽光パネルや大型ディスプレーなど環境・エレクトロニクス製品の低コスト・大量生産の実用化に大きく貢献できると期待されている。

出展内容は次の通り。

①「プリンデッドエレクトロニクス最適生産システム展 PE PROCESS」（新設）＝プリンテッドエレクトロニクス基板、ディスプレー製品、次世代照明、太陽電池、燃料電池などの応用製品、導電性材料、半導体材料、絶縁性材料などの材料。

②「部品・MEMS／デバイス産業総合資機材展 Device Engineering」＝金属酸化膜半導体（MOS）ロジック／マイクロ／メモリー半導体、デジタルバイポーラ半導体、光MEMS、センサーMEMSなどの製品、半導体シリコン、化合物半導体材料、磁性材料、成膜・配線形成材料などの材料・プロセス材料。

③「LED／OLED応用技術展 SS（Solid-State）Lighting」＝高輝度LED、有機エレクトロルミネッセンス（EL）、パワーIC／絶縁ゲートバイポーラトランジスタ（IGBT）／インバーターなどハイパワーデバイスを実装する電子回路基板製品や実装済み電子回路実装基板、LED／OLED照明用デバイスなどの応用製品、結晶基板、電極材料などの材料・プロセス材料。

Large Electronics Show 2012
ラージエレクトロニクスショー2012

## 最先端の実装技術 発信

JIEP 2012 マイクロエレクトロニクスショー
第26回 最先端実装技術・パッケージング展

実装要素技術の専門展であるマイクロエレクトロニクスショーは、最新エレクトロニクス実装の開発や設計に携わる第一線技術者を中心とした最も歴史ある展示会。最先端実装技術発信の場として広く認知されている。

出展内容は、最先端将来技術を中心とした高密度・高周波実装技術応用製品、高密度サブストレート・イアンターポーザ

## JISSO PROTEC2012 高密度・超精密へ

JISSO PROTECは生産技術・実装プロセス技術の専門展。スマートフォン（多機能携帯電話）やタブレット端末など多機能電子機器の小型・薄型・軽量化を支える高密度・超精密実装の最新技術・製品を知ることができる。

出展製品は高精度化が進む電子デバイスのマウンターやインサーター、ディスペンサーから、デップ槽、リフローオーブンといったクリームハンダ印刷、ハンダ付け装置関連機器、ワイヤボンダーやダイボンダーといった半導体実装機、さらには基板外観などを検査するための測定機器や試験装置、実装設計システム、各種材料。

実装技術・製品の展示に加えて、東4ホールの「実装体験コーナ」では来場者参加型のオープンセミナーが開催される。ロボットキットを使った部品実装を体験できる。会期中に6回開かれ、1回の定員は15人。参加費は無料。


●PWB Tech 2012　2012プリント配線板技術展　東展示棟　51-25

基板の設計から実装までの一貫製造を中心に、
各種電子機器の多品種・小ロット・試作に短納期で対応。
中小ロット基板の海外生産（中国）も手掛けております。

海外生産イメージ

◇小ロット多品種～試作短納期対応～中国生産
◇片面～高多層基板・高密度基板・特殊基板
◇ビルドアップ基板・アルミ基板（片面・アルミコア基板）
◇基板設計　EMC対策・シュミレーション
◇実　　装　部材調達から実装までを短納期にて。リワークにも対応します。

富士プリント工業株式会社
本社・工場　〒192-0154　東京都八王子市下恩方町315-11
TEL:042-650-8181　FAX:042-652-5400
国内事業所　東北営業所・大阪営業所（TEL：06-6398-0011）
中国事業所（深圳）　富士電路科技（香港）有限公司

☑スマートフォンにも

高機能化・小型化が進む各種電子機器には、さまざまな機能を実現するための材料技術が凝縮されています。たとえばスマートフォンにも、回路基板材料「エスパネックス®」をはじめ、液晶ディスプレイ材料「エスファイン®」や実装材料「エスアレックス®」、高性能エポキシ樹脂など、私たちの材料技術が活かされています。使いやすさの追求や、さらなる高機能化のニーズへ応えるために、高い表面硬度をもつ「シルプラス®」や光学材料の「エスドリマー®」、次世代ディスプレイの有機EL材料「ルミエース®」など、新たな技術の開発が進められています。

For Your Dream & Happiness

いつでも最先端に。

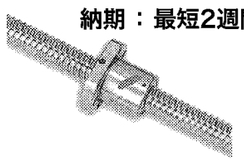
新日鐵化学

【主要営業品目】
■コールケミカル事業
※炭素材 ※カーボンブラック ※特殊炭素製品 ※工業用ガス
■化学品事業
※化学品類 ※潤滑材
■光学・ディスプレイ材料事業
※機能樹脂材料 ※高表面硬度透明基板「シルプラス®」
※ディスプレイ材料「エスファイン®」
■エポキシ事業
※エポキシ樹脂 ※フェノール類
■回路基板材料事業
※FPC用無接着剤銅張積層板「エスパネックス®」
■有機EL材料事業
※有機EL材料「ルミエース®」

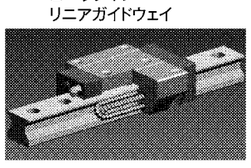
新日鐵化学 Nippon Steel Chemical Group　〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX13F　TEL.03-5207-7600　URL http://www.nscc.co.jp



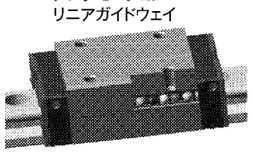
短納期
転造ボールねじ（日本国内在庫）
納期：最短2週間～



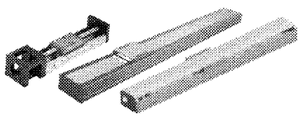
高剛性
ローラタイプ
リニアガイドウェイ



高速・静音
シンクモーション
リニアガイドウェイ

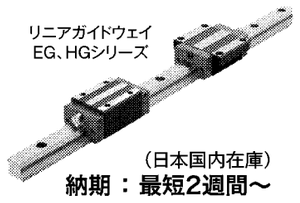


静音・高剛性
工業ロボット
（KK、KA、KSシリーズ）



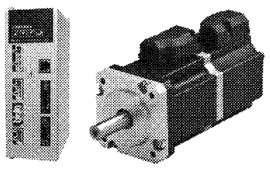
HIWIN®
Motion Control and System Technology
直動製品の最強パートナー

リニアガイドウェイ
EG、HGシリーズ



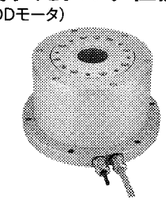
（日本国内在庫）
納期：最短2週間～

優れた経済性・制御性
ACサーボモータ、ドライバ



高速・高精度
リニアモータ（コアレス、コア付）

優れたトルク性能
（DDモータ）



ハイウィン株式会社 HIWIN CORPORATION
〒651-0087　神戸市中央区御幸通4丁目2−20　三宮中央ビル3階
Tel: (078)262-5413　Fax: (078)262-5686
http://www.hiwin.co.jp　E-mail: info@hiwin.co.jp

東京支店：Tel: (042)358-4501　Fax: (042)358-4519
名古屋支店：Tel: (052)587-1137　Fax: (052)587-1350
三河安城営業所：Tel: (0566)74-2911　Fax: (0566)74-6411
九州営業所：Tel: (096)340-2282　Fax: (096)340-2286
ロボット事業部：Tel: (042)358-4503　Fax: (042)358-4518

JPCA Show2012 出展
会期:2012年6月13日㈬～15日㈮
会場:東京ビッグサイト
小間番号 東3ホール 3B33